ADIC013 Vo

性能特点

• 频率范围: 0.7 GHz - 6 GHz

• 小信号增益: 27 dB

• 饱和输出功率: 43 dBm @ 25% PAE

• 直流供电: Vd= 36 V @ Id= 1.1 A

(Vq = -2.25 V)

• 芯片尺寸: 4.75 mm×3.50 mm×0.08 mm

产品简介

ADIC013是一款宽带功率放大器芯片, 频率范围覆盖0.7 GHz - 6 GHz, 小信号增益 典型值为27 dB, 饱和输出功率典型值为43 dBm。

极限参数

栅极负电压	-5 V		
漏极正电压	40 V		
输入功率	28 dBm		
存储温度	-65 ℃~150 ℃		
使用温度	-55 °C~85 °C		

外形尺寸

3500	3670 4470
2370-1 RFIN	5 6 G1 G2 RFOUT 2 -2370
D1 D2 3 4	
0 420 1070	4750

注: 1) 所有标注尺寸单位为微米(µm);

2) 外形长宽尺寸公差: ±50 µm;

3) 芯片厚度80 µm。

键合压点定义

编号	符 号	功能描述	尺寸(µm²)
1	RFin	射频信号输入端,外接50 欧姆系统,无需隔直电容	110×150
2	RFout	射频信号输出端,外接50 欧姆系统,无需隔直电容	110×150
3、4	D1,D2	漏极电压馈电端,需外置 1000 pF和1 uF旁路电容	300×120
5、6	G1,G2	栅极电压馈电端,需外置 100 pF、1000 pF和0.01 uF旁路电容	110×110

电性能表 (Vd= 36 V, Id= 1.1 A, TA= +25 ℃)

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	0.7		6	GHz
小信号增益		27		dB
饱和输出功率		43		dBm
功率附加效率		25		%
输入驻波		1.5		-
输出驻波		2.0		-
静态电流		1.1		Α



服务热线: 028-61399584

ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS



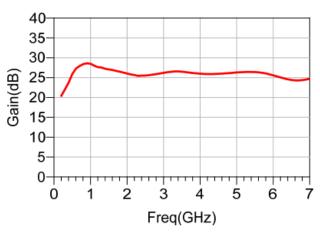
关注公众号

更新日期: 2021-12-01

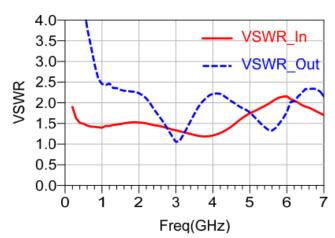
ADIC013 V0

在片测试曲线 (T= +25 °C, Vd= 36 V, Id= 1.1 A)

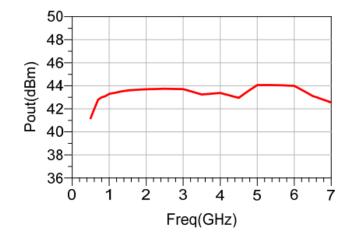




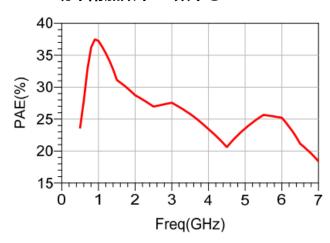
输入输出驻波vs.频率



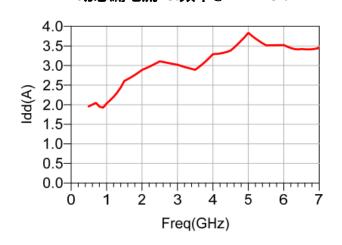
输出功率vs.频率@Pin=23 dBm



功率附加效率vs.频率@Pin=23 dBm



动态漏电流vs.频率@Pin=23 dBm

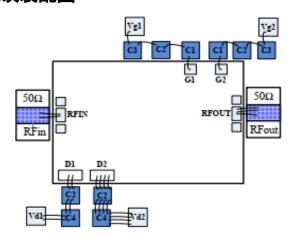


功率增益vs.频率@Pin=23 dBm



ADIC013 Vo

建议装配图



注: 外围电容C1容值为100 pF, C2容值为1000 pF, C3容值为0.01 μF, C4容值为1 μF

注意事项

1.存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

2.清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

3.静电防护:请严格遵守ESD防护要求,避免静电损伤。

4.常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

5.加电顺序:加电时,先加栅压,后加漏压;去电时,先去漏压,后去栅压。

6.装架操作:芯片安装可采用AuSn焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺,安装面必须清洁平整,芯片与输入输出射频连接线基板的缝隙尽量小。

7.烧结工艺: 用80/20 AuSn烧结,烧结温度不能超过300 ℃,烧结时间尽量短,不要超过20秒,摩擦时间不要超过3秒。

8.粘接工艺:导电胶粘接时点胶量尽量少,固化条件参考导电胶厂商提供的资料。

9.键合操作:无特殊说明,射频输入输出用2根键合丝(直径25 µm金丝),键合线尽量短。热超声键合温度150 ℃,采用尽可能小的超声能量。球形键合劈刀压力40~50 gf,楔形键合劈刀压力18~22 gf。10.有问题请与供货商联系。

服务热线: 028-61399584

更新日期: 2021-12-01